

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年10月27日(27.10.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/224333 A1

(51) 国際特許分類:
C08L 23/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/015975

(22) 国際出願日: 2021年4月20日(20.04.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 日本 サニ パ ッ ク 株 式 会 社
(SANIPAK COMPANY OF JAPAN, LTD.) [JP/
JP]; 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1 丁
目 2 5 番地 5 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 堀 籠 良 博 (HORIGOME Yoshihiro);
〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1 丁目 2 5
番地 5 日本サニパック株式会社内 Tokyo
(JP). 大崎 学 (OSAKI Manabu); 〒1510072 東
京都渋谷区幡ヶ谷 1 丁目 2 5 番地 5 日本
サニパック株式会社内 Tokyo (JP). 中川 康
弘 (NAKAGAWA Yasuhiro); 〒1510072 東京
都渋谷区幡ヶ谷 1 丁目 2 5 番地 5 日本サ
ニパック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 西澤 和純, 外(NISHIZAWA Kazuyoshi
et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一
丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,

(54) Title: POLYETHYLENE-BASED RESIN COMPOSITION AND POLYETHYLENE-BASED RESIN PACK-
AGING MATERIAL

(54) 発明の名称: ポリエチレン系樹脂組成物およびポリエチレン系樹脂包装材

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide: a polyethylene-based resin composition from which a film can be obtained which has, even when an inorganic compound is added thereto, the combination of film strength, elongation, sealing strength, and impact strength; and a polyethylene-based resin packaging material. This polyethylene-based resin composition contains an inorganic compound and a resin component. The resin component contains: an ethylene- α -olefin copolymer A that is obtained through copolymerization of ethylene and an α -olefin having 6-8 carbon atoms and that has a melt flow rate of 0.8-4.0 g/10 min.; and a high density polyethylene and/or an ethylene- α -olefin copolymer B that is obtained through copolymerization of ethylene and an α -olefin having 4 carbon atoms. The contained amount of the inorganic compound is 30-65 mass% with respect to the total mass of the resin composition. The contained amount of the ethylene- α -olefin copolymer A is 50-95 mass% with respect to the total mass of the resin component.

(57) 要約: 無機化合物が添加されていてもフィルム強度、伸び、シール強度、衝撃強度を兼ね備えたフィルムが得られるポリエチレン系樹脂組成物、およびポリエチレン系樹脂包装材を提供することを目的とする。無機化合物と樹脂成分とを含むポリエチレン系樹脂組成物において、樹脂成分が、エチレンと炭素数 6 ~ 8 の α -オレフィンとが共重合され、かつメルトフローレートが 0.8 g / 10 分以上 4.0 g / 10 分以下であるエチレン- α -オレフィン共重合体 A と、高密度ポリエチレンおよびエチレンと炭素数 4 の α -オレフィンとが共重合されたエチレン- α -オレフィン共重合体 B のいずれか一方または両方を含み、無機化合物の含有量を樹脂組成物の総質量に対して 30 質量%以上 65 質量%以下とし、前記エチレン- α -オレフィン共重合体 A の含有量を樹脂成分の総質量に対して 50 質量%以上 95 質量%以下とする。

WO 2022/224333 A1

[続葉有]

SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）